



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D237600 S

(45)公告日：中華民國 114 (2025) 年 04 月 11 日

(21)申請案號：113303708

(22)申請日：中華民國 113 (2024) 年 07 月 18 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2024/01/18

南韓

30-2024-0002433

(71)申請人：韓商惠康有限公司(南韓)HICON CO., LTD. (KR)

南韓

黃東源(南韓)HWANG, DONG WEON (KR)

南韓

黃 裁白(美國)HWANG, JAE BAEK (US)

美國

(72)設計人：黃東源 HWANG, DONG WEON (KR)；黃 裁白 HWANG, JAE BAEK (US)；黃
路建載 HWANG, LOGAN JAE (US)

(74)代理人：張仲謙

(56)參考文獻：

TW M625977

TW 201905468

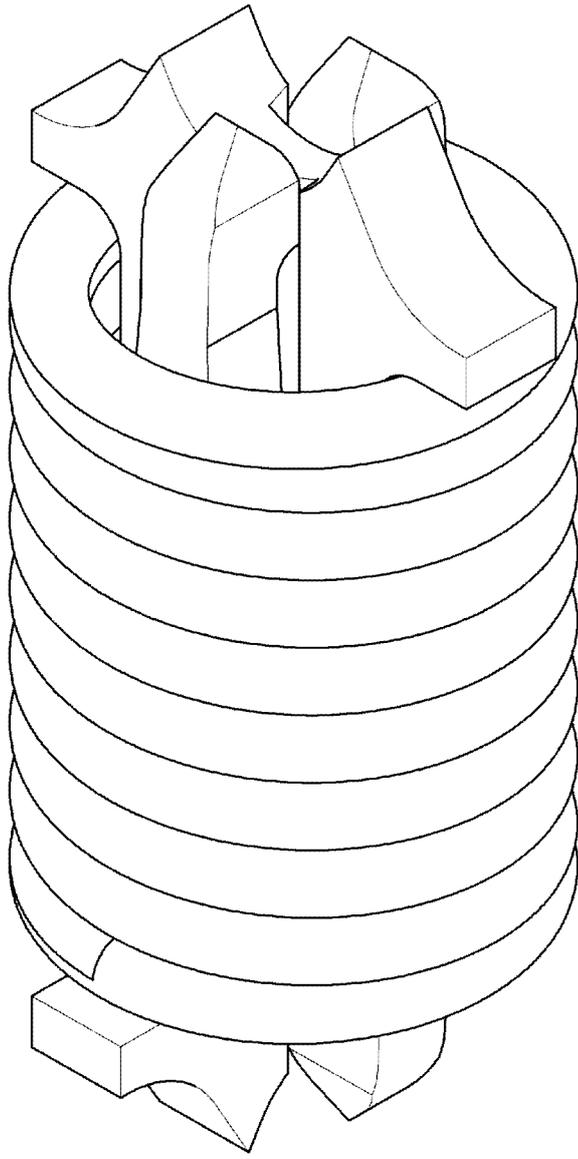
審查人員：徐銘鋒

圖式數：8 共 9 頁

(54)名稱

IC 測試用探針

代表圖：



【立體圖】



D237600

【設計說明書】

【中文設計名稱】 IC測試用探針

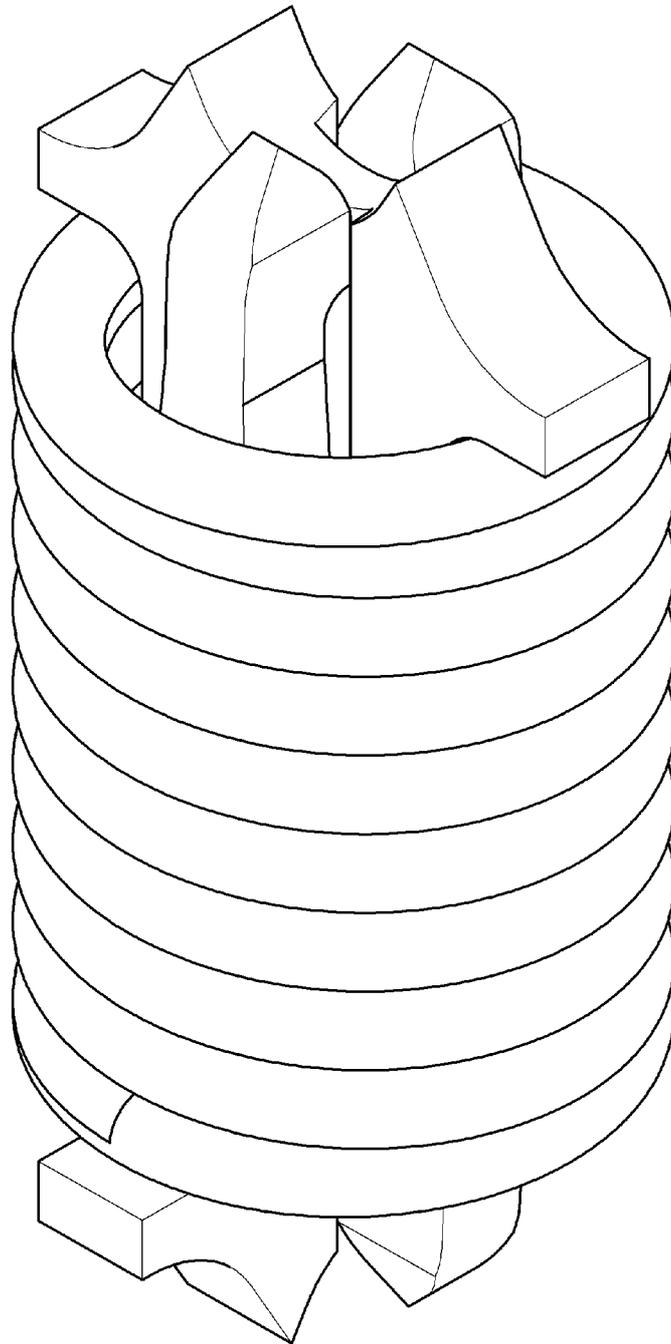
【物品用途】

【0001】 本設計係關於一種IC測試用探針，特別是有關於一種用於檢查電子元件之IC測試用探針。

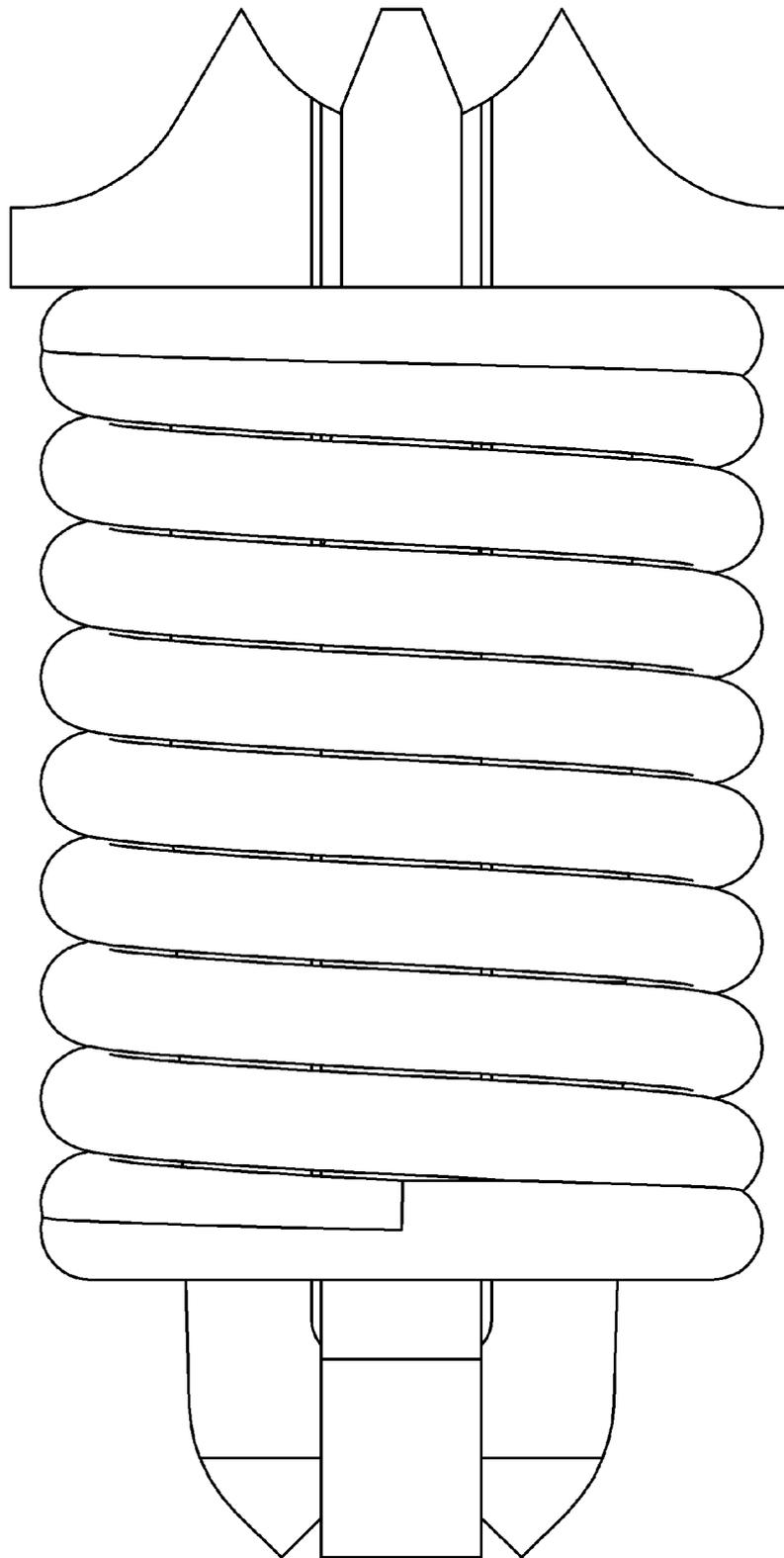
【設計說明】

【0002】 本設計係與待檢查物體的電極、端子或焊盤接觸的探針，例如半導體裝置、半導體封裝、積體電路、印刷電路板等。在檢查過程中，電訊號從基板和IC與接觸的上探針經過下探針流向下方。本設計在最大壓縮下，上探針和下探針可同時直接接觸IC和基板以流動電流。

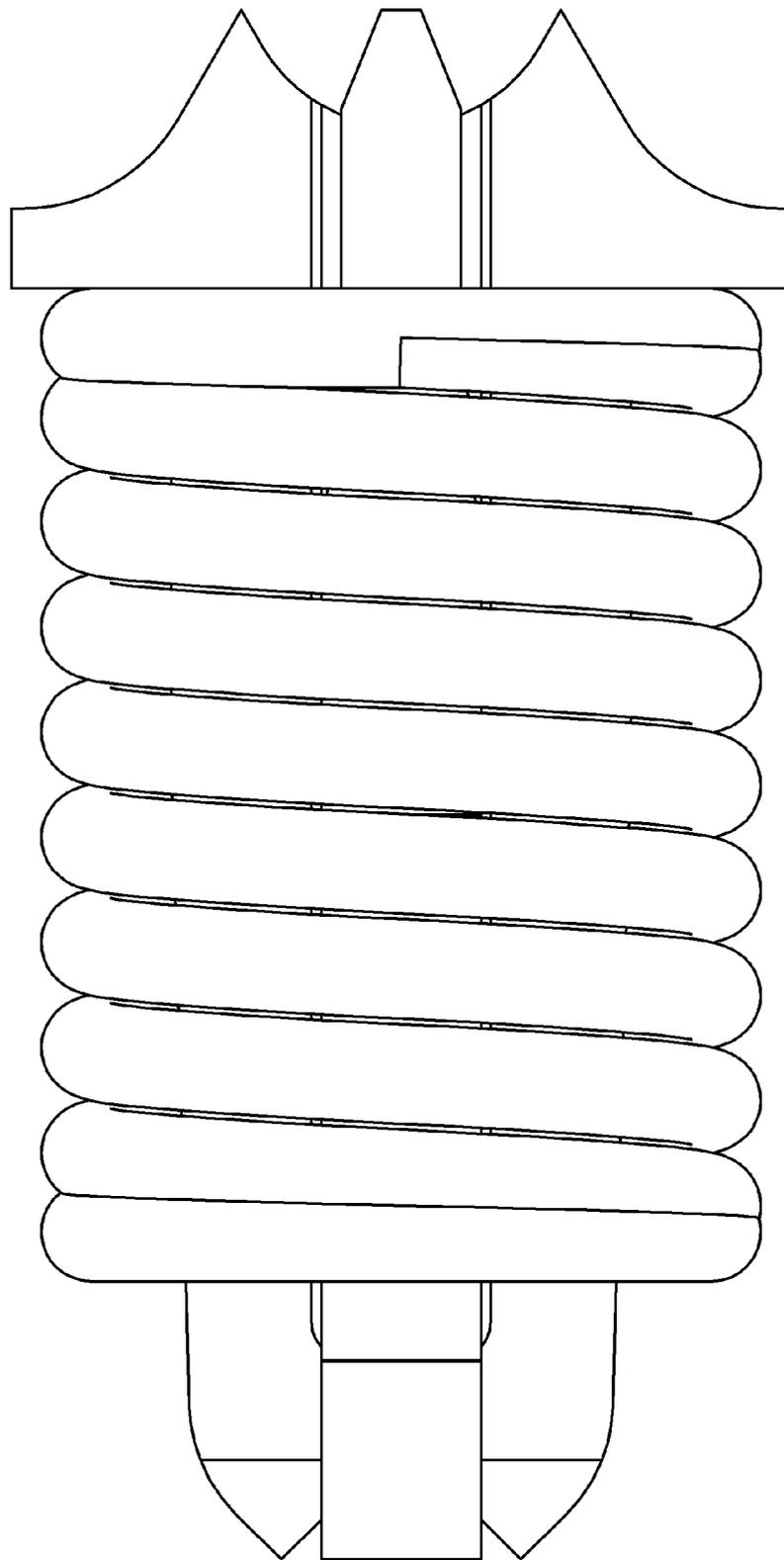
【設計圖式】
(指定代表圖)



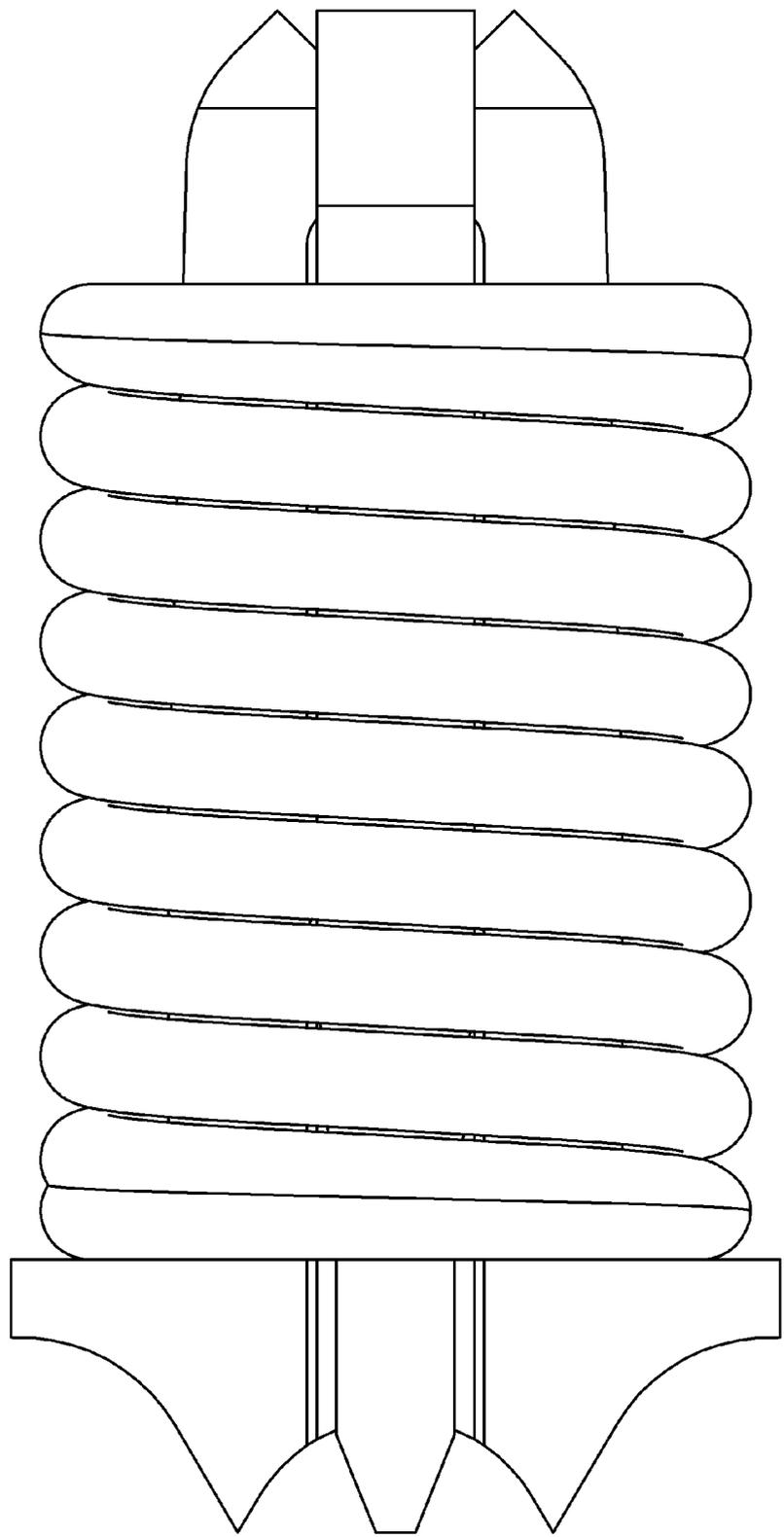
【立體圖】



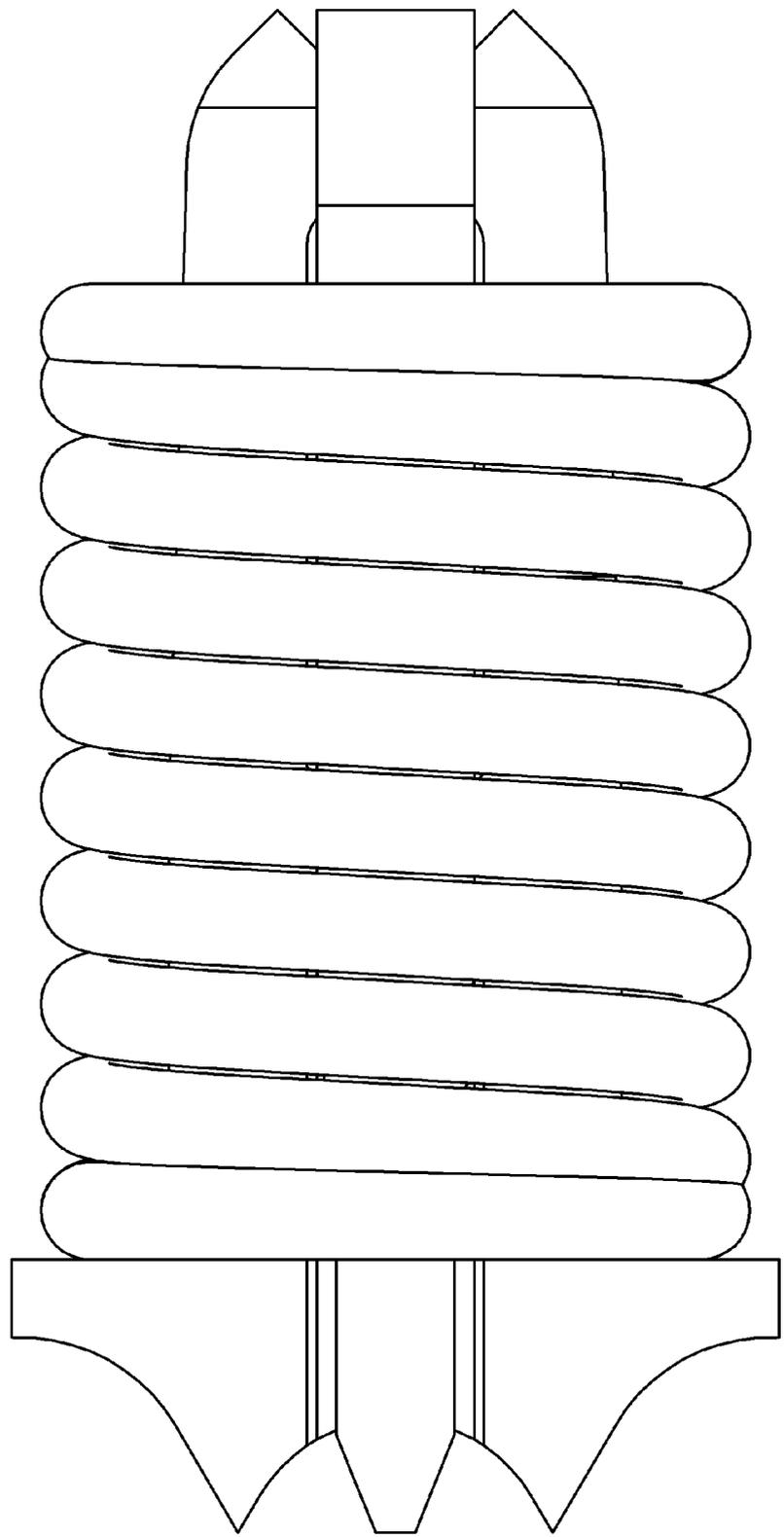
【前視圖】



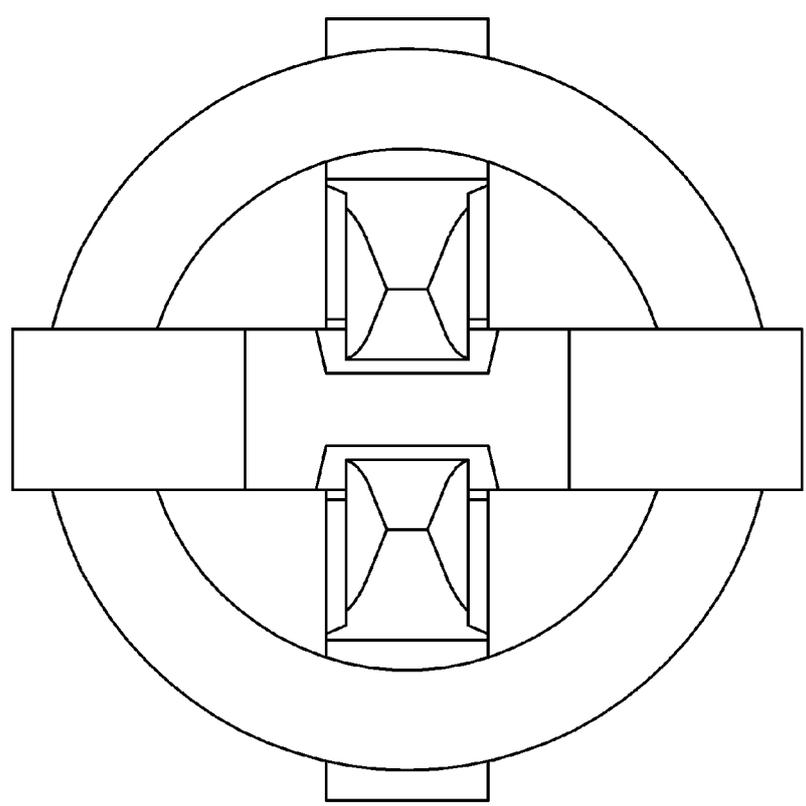
【後視圖】



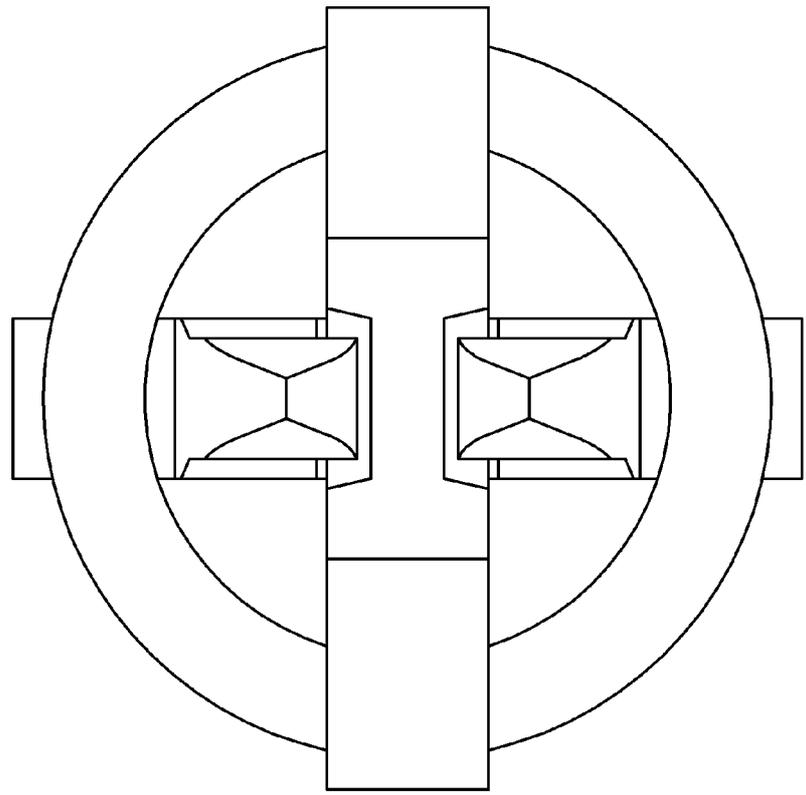
【左側視圖】



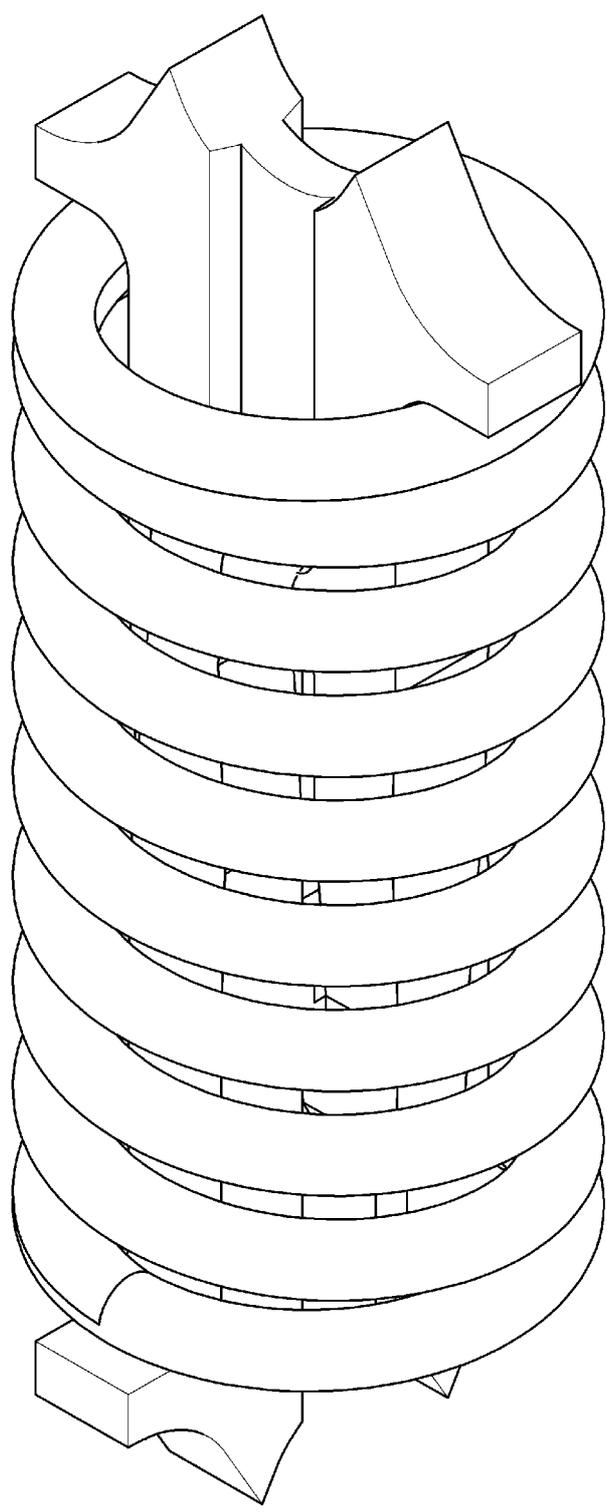
【右側視圖】



【俯視圖】



【仰視圖】



【未壓縮時之狀態參考圖】